

國立政治大學 函

機關地址：臺北市文山區指南路二段64號

機關傳真：29387749

承辦人：陳瑞英

聯絡電話：02-29393091#66899

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國106年11月14日

發文字號：政研發字第1060034222號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：附件一科技部函、附件二本校函、附件三業界合作意願書、附件四修正版計畫徵求公告、附件五申請人承諾書

主旨：函轉科技部修正107年度「智慧終端半導體製程與晶片系統研發專案計畫」，校內線上截止收件時間原106年11月14日(星期二)更正為106年12月25日(星期一)下午5時，請查照轉知。

說明：

- 一、依科技部106年11月10日科部工字第1061005863號函(附件一)暨106年9月8日政研發字第1060026636號函(附件二)諒達辦理。
- 二、科技部修正重點摘錄如下：
 - (一) 增列主軸六「新興半導體製程、材料與元件技術」，同時主軸一名稱原為「關鍵元件、製程與材料、感測器」修正為「前瞻感測元件、電路與系統」。
 - (二) 本專案為整合型計畫，每一整合型計畫需含總計畫與(三個(含)以上，最多以不超過六個為原則)之子計畫。
 - (三) 原計畫名稱「智慧終端半導體製程與晶片系統研發專案計畫」修正為「智慧終端半導體製程與晶片系統研發專案計畫(半導體射月計畫)」。
 - (四) 計畫具體目標導向：總計畫內容須明確陳述整體總目標，應具有開創新思維且以挑戰數量等級的規格改善為宗旨。
 - (五) 申請團隊於提出總計畫書時，必須包含【業界合作意願書】(附件三)，請將此意願書附於計畫書表CM03 研究計畫內容之後，並於計

畫內容簡述申請團隊與業界預計之合作方式。

(六) 本計畫規劃四年期間修正自107年5月1日至111年4月30日。

(七) 有意申請者，請於旨揭期限前至科技部線上申請系統完成申請，請所屬單位於106年12月26日(星期二)中午12點將申請名冊送達研發處，俾利備函彙送科技部提出申請。

三、本計畫徵求公告(附件四)、申請人承諾書(附件五)等相關訊息已公佈於科技部網站與科技部工程司網站 (<https://www.most.gov.tw/eng/ch>) -公告事項參閱下載。

四、計畫申請如有疑慮，請洽科技部潘敏治副研究員，電話：(02)2737-7983。申請系統操作問題，請洽科技部資訊處，聯絡電話：0800-212-058，(02) 2737-7590~92。

裝 正本：本校各院、所、系、中心

副本：研究發展處

校長 周 行 一

訂

線